

PMGI & LOR

2層リフトオフプロセス用犠牲層レジスト

MICRO CHEM

NIPPON
KAYAKU

PMGI & LOR は2層リフトオフプロセスの犠牲層に用いられ、高解像度のリフトオフやメタルの厚膜リフトオフが可能です。

中空構造や3次元構造の犠牲層としても使用することができます。

一般的なフォトレジストには不溶であり、アンダーカットの形成はアルカリ系現像液をご使用頂くことができ、NMPベースの剥離液にて除去が可能です。

特徴

- 一般のフォトレジストとアルカリ系現像液が使用可能
- アンダーカットの制御が容易
- NMPベースの剥離液にてレジスト除去
- 幅広い膜厚で使用可能

Process Flow



1. PMGI & LOR 塗布後、ソフトベーク



2. ソフトベーク後、イメージング層の塗布



3. イメージング層の露光



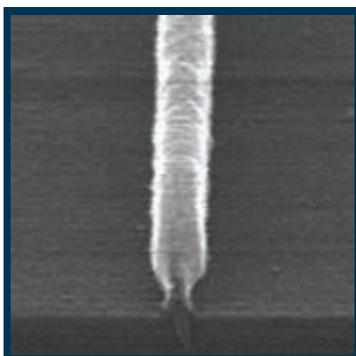
4. 現像およびアンダーカット



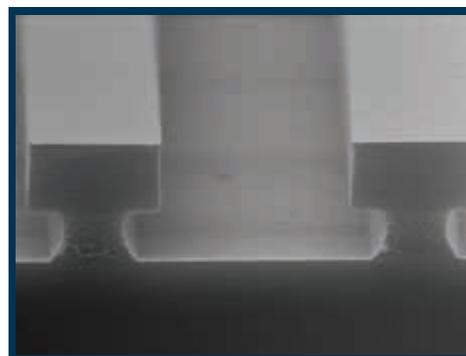
5. メタル蒸着



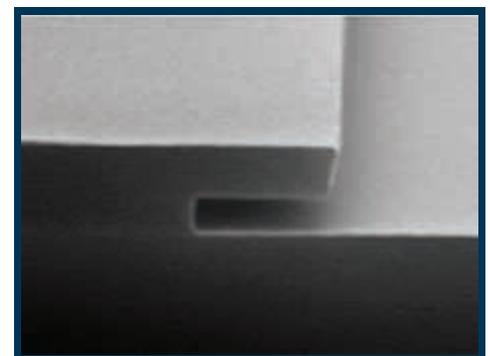
6. リフトオフ層の剥離



SFG2 - 80 nm line



LOR 30B 5 μm lines



PMGI 0.6 - 3 μm line

(販売元)

日本化薬株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
TEL. 03-6731-5266

製作: KMCC
2008.07.28